

# マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ ～電子デバイス実装の現状と新展開～

## 【主催】

一般社団法人 日本溶接協会  
マイクロソルダリング要員認証委員会、マイクロソルダリング要員評価委員会、マイクロソルダリング教育委員会

## 【開催日時および会場】

平成 27 年 10 月 20 日（火） 10：30～17：00 於：芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟 大講義室

## 【開催趣旨】

電子・電気製品には目まぐるしく変化する様々な分野の新技术が採用されており、それを支える実装技術では厳しい環境での使用や長期運用など、高い製造技術・材料・評価試験方法・検査方法による高い品質、高い信頼性が求められています。

日本溶接協会では、平成 4 年よりマイクロソルダリング技術の教育および技術資格の認証を行っており、累計で 2 万人を越える皆様にご活用頂いております。その資格取得者を中心に様々な方々に対して、最新のマニュアルソルダリング用機器・材料・装置の展示、

最新の技術動向を通じてマイクロソルダリング実装の展開を知って頂く場として、平成 18 年から「マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ」を開催しております。

本年度は、「電子デバイス実装の現状と新展開」をテーマに、これまでの実装関連の変遷、海外での取り組みや最新の情報をご紹介させて頂くことと致しました。事業主や製造責任者の方々にも参加頂き、基盤技術としてのマイクロソルダリング技術・実装技術を深くご理解頂ければ幸いです。

## 【プログラム】

10:30-10:35	開会の挨拶 マイクロソルダリング要員評価委員会 委員長 藤本 公三
10:35-11:10 (35分)	「高温・高電流密度実装における はんだ接合部エレクトロマイグレーション」 中京大学 工学部 電気電子工学科 山中 公博
11:10-11:45 (35分)	「はんだフラックス由来の臭素が関与したSn0ウイスカの発生とリスク予測」 (株) 村田製作所 信頼性技術センター 斎藤 彰
11:45-12:30	展示品紹介 (5分程度/1社)
12:30-14:00	昼食休憩・展示見学
14:00-14:20	マイクロソルダリング技術賞 表彰式
14:20-14:40 (20分)	「マイクロソルダリング技術資格制度の概要」 (一社) 日本溶接協会 日暮 宏彰
14:40-15:30 (50分)	「製造業を取り巻く環境変化と実装モノづくり革新」 (株) 東芝 森 郁夫
15:30-15:45	休憩・展示見学
15:45-16:20 (35分)	「はんだ材料技術の最新動向と市場動向」 千住金属工業 (株) ハンダテクニカルセンター 秋田 智
16:20-16:55 (35分)	「最近の実装技術動向とその信頼性評価技術の取り組み」 エスペック (株) テストコンサルティング本部 高橋 邦明
16:55-17:00	閉会の挨拶 マイクロソルダリング教育委員会 委員長 佐藤 武彦

## 【 参加申込方法 】

本紙下部の申込書(コピー可)に必要な事項を記入し、下記申込先にFAXにて平成27年10月14日までにお送り下さい。受付後、折り返し参加票をFAXにて送付致します。フェスタ当日は、必ず会場受付まで参加票をお持ち下さい。参加票をお持ちでは無い方は、ご入場をお断りする場合がございます。

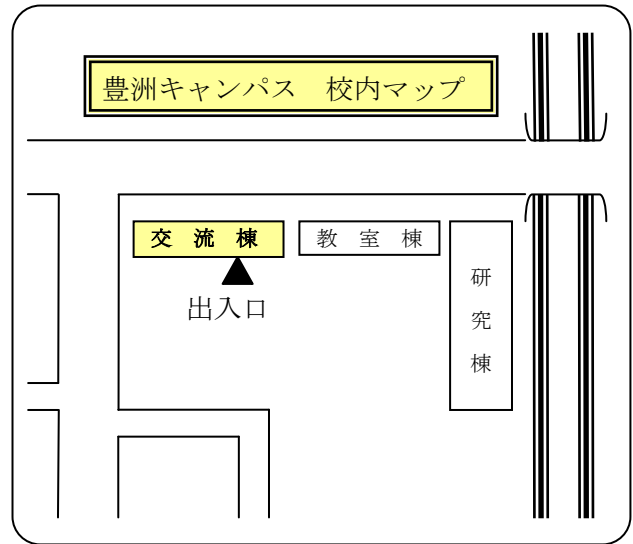
会 場 : 芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟 大講義室 (〒135-8548 東京都江東区豊洲 3-7-5)

参加定員 : 400名 (先着順、定員になり次第締切り)

参加費用 : 無 料

お申込先 : (一社)日本溶接協会 担当 : 日暮、菅沼 (TEL : 03-5823-6325 FAX : 03-5823-5211)

## 【 会場案内図 】



FAX : 03-5823-5211 一般社団法人 日本溶接協会  
マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ 事務局 宛

## <<参加申込書>>

ふりがな		
氏名	(姓)	(名)
ふりがな	ふりがな	
勤務先 (所属先名)	電話番号 ( )	FAX ( )
同 上 所在地	〒	
E-mail		

※ 複数のお申し込みの場合には、本紙をコピーしてお使い下さい。